

2018-2024年中国半导体未来趋势预测分析及投资 规划研究建议报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2018-2024年中国半导体未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/360290.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体产业起源地为美国，美国迄今仍在IDM模式（从设计、制造、封装测试以及投向消费市场一条龙全包）及垂直分工模式中的半导体产品设计环节占据绝对主导地位，而存储器、晶圆代工及封测等重资产、附加值相对低的环节陆续外迁。由于半导体属于技术及资本高度密集型行业，只有下游终端需求换代等重大机遇来临时，新兴地区通过技术引进、劳动力成本优势才有机会实现超越，推动产业链迁移。

第一次半导体迁移发生在大型计算机时代，存储器制造环节由美国向日本转移。日本凭借规模化生产技术占据成本和可靠性优势，成为DRAM（动态随机存取存储器）主要供应国。此次迁移对上游带动作用明显，即便后期日本丧失存储器优势，迄今仍在上游原材料、设备领域占据领先地位。

第二次半导体迁移发生在PC时代，PC对DRAM的诉求由可靠性转变为低价，韩国凭借劳动力优势取代日本的地位，至今仍主导存储器市场。

与此同时，台湾首创垂直分工模式，逐步形成IC（集成电路）设计、晶圆代工、封测联动的产业集群。随着全球移动产品盛行、迭代速度更快，垂直分工模式以其更短的产品生命周期及更具竞争性的价格逐渐占据主导地位，长期引领全球圆晶代工、封测等环节。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章半导体产业概述6
第一节半导体产业定义6
第二节半导体产业发展历程6
第三节半导体分类情况6
第四节半导体产业链分析9
一、产业链模型介绍9
二、半导体产业链模型分析10
第二章中国半导体产业发展环境分析11
第一节中国经济环境分析11
一、宏观经济11
二、工业发展形势20
三、固定资产投资分析22
第二节半导体产业相关政策25
一、国家“十三五”产业政策25

二、其他相关政策	26
第三节中国半导体产业发展社会环境分析	28
第三章全球半导体市场分析	29
第一节全球市场发展概要	29
第二节全球主要国家发展情况	30
一、美国	30
二、日本	32
三、韩国	34
四、欧洲	34
第三节国外重点厂商分析	35
第四章中国半导体产业供需现状分析	39
第一节半导体产业总体规模	39
第二节半导体产能概况	40
一、2014-2017年产量及规模	40
二、2018-2024年产量规模预测	42
第三节半导体市场需求概况	42
一、2014-2017年市场销售量及规模分析	42
二、2018-2024年市场需求量规模预测	43
第四节进出口分析	44
第五章中国半导体产业总体发展状况	45
第一节市场现状	45
一、市场概要	45
二、市场供需平衡度	46
三、消费特征	47
四、销售模式	47
第二节市场壁垒	54
第三节产业竞争结构分析	55
一、现有企业间竞争	55
二、潜在进入者分析	55
三、替代品威胁分析	56
第四节国际竞争力比较	56
第五节推动市场要素及阻碍因素	57
第六章2014-2017年我国半导体产业重点区域分析	60
第一节华北	60
第二节华南	61

第三节华东63

第四节华中68

第五节其它地区（西南、西北、东北）68

一、部分企业概况68

二、市场销售状况69

第七章半导体产业市场分析70

第一节重点产品70

一、市场占有率70

二、市场应用及特点70

三、供应商分析71

第二节技术分析74

一、技术现状74

二、创新技术研发及方向77

第三节产品细分78

第四节市场价格分析79

第八章半导体国内典型企业80

第一节中芯国际80

一、简介80

二、企业经营与财务状况分析80

三、企业竞争优势分析80

四、企业未来发展战略与规划81

第二节上海新阳半导体材料股份有限公司81

一、简介81

二、企业经营与财务状况分析81

三、企业竞争优势分析82

四、企业未来发展战略与规划82

第三节上海复旦83

一、简介83

二、企业经营与财务状况分析83

三、企业竞争优势分析83

四、企业未来发展战略与规划84

第四节长电科技84

一、简介84

二、企业经营与财务状况分析84

三、企业竞争优势分析85

四、企业未来发展战略与规划86

第五节银河半导体86

一、简介86

二、企业经营与财务状况分析86

三、企业竞争优势分析87

四、企业未来发展战略与规划88

第九章2018-2024年半导体产业发展趋势及投资风险分析89

第一节当前半导体市场存在的问题89

第二节半导体未来发展预测分析89

一、2018-2024年中国半导体产业发展规模89

二、2018-2024年中国半导体产业技术趋势预测90

三、总体产业“十三五”整体规划及预测90

第三节2018-2024年中国半导体产业投资风险分析91

一、市场竞争风险91

二、原材料压力风险分析92

三、技术风险分析92

四、政策和体制风险95

五、外资进入现状及对未来市场的威胁96

图表目录：

图表1半导体相关产业6

图表2半导体元素7

图表3国内半导体产业链结构10

图表42014-2017年主要经济指标11

图表52014-2017年中国进出口与国内消费状况12

图表6中国货币供应、通货膨胀与经济增长变化情况12

图表72014-2017年中国gdp增长的拉动情况14

图表82014-2017年全球主要发展中国家人均gdp变化趋势14

图表92014-2017年各国服务业增加值占gdp比重情况14

图表102014-2017年中国服务业就业占gdp比重15

图表112010年以来中国体制改革与中国经济周期15

图表122014-2017年中国经济目标与实际表现17

图表132018-2024年各行业居民消费增长预测17

图表142018-2024年中国消费率预测18

图表15中国中学入学率仍比发达国家低19

图表16未来十年新城镇化将推动中国消费需求20

图表172014-2017年中国固定资产投资完成额累计同比(%) 23

图表182014-2017年固定资产完成额中央和地方项目累计同比(%) 23

图表192014-2017年中国基建投资拉动工业生产23

图表202014-2017年国家预算内资金是主要来源24

图表21房地产销售回升带动新开工回升24

图表222014-2017年中国固定投资状况统计表24

图表232014-2017年全球半导体市场规模与增长29

图表242017年全球半导体市场产品结构29

图表252014-2017年美国半导体月度销售额及增长率30

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/360290.html>